

## 第四届半导体行业用陶瓷材料技术大会

半导体产业是高度技术密集型产业，以精密陶瓷部件、陶瓷基板为代表的陶瓷材料在半导体设备、先进封装等环节发挥着关键作用，是集成电路核心技术的载体，是半导体产业的基石。在我国大力扶持半导体产业的背景下，全球半导体全产业链产能正向我国加速转移，尽管半导体行业用陶瓷材料已经引起各级政府及产研界的重视和投入，但国产替代率仍然不高，替代空间仍然广阔。

此外，随着半导体制程工艺向 7nm 及更高的水平发展，半导体设备的生产效率和精度不断提高，对陶瓷材料零部件的理化性能指标要求也在不断提高。半导体行业技术快速迭代升级的行业特性要求先进陶瓷企业不断改进材料配方和加工工艺，进行产品的持续开发换代。

在此背景下，中国粉体网将于 2025 年 5 月在**江苏·昆山**举办**第四届半导体行业用陶瓷材料技术大会**，旨在为半导体和先进陶瓷行业搭建沟通平台，交流先进技术，互通行业信息，促进产业链合作，推动国产替代进程。

会议热诚欢迎行业专家、学者、技术人员、企业界代表出席，同时欢迎公司、企事业单位展示技术成果，洽谈产、学、研合作。

### 时间

2025 年 5 月 13 日

（5 月 12 日报到）

### 地点

昆山皇冠国际会展酒店

江苏省苏州市昆山市前进西路 1277 号

### 主办单位



### 联合主办

**江苏密友粉体新装备制造有限公司**

### 会议主题

- 1、符合行业要求的高端粉体、成型、烧结、机械加工技术
- 2、符合行业要求的氧化物、碳化物、氮化物、堇青石等陶瓷制品性能
- 3、半导体行业用先进陶瓷产品市场规模及国产化前景
- 4、电动汽车、5G、人工智能等热点应用领域及新兴市场分析
- 5、第三代半导体带来的先进陶瓷市场机会

## 特色活动

大会征集参会企业相关技术合作、产品采购，工艺方案等需求进行现场采配活动，相关信息将进行展板展示，提高现场沟通交流效率！

征集内容包含但不限于以下几点：

- 1、行业投资、融资需求
- 2、科研成果转化
- 3、产品工艺问题解决方案
- 4、原料、设备、仪器采购需求

## 会议费用

2800 元/人

费用包含：会议资料费、会议餐费、茶歇、会务服务等费用，不含住宿

## 收款账户

户名	山东中粉电子商务有限公司
开户行	中国建设银行股份有限公司临沂分行
账号	37050182830100000331

## 会务组

联系人：任海鑫

联系方式：18660985530（微信同号）

